

半導体装置の製造方法事件（審決取消請求事件）	
事件の表示	平成23年（行ケ）第10121号 平成24年1月31日判決言渡 原告：ルネサスエレクトロニクス株式会社 被告：特許庁長官
判決	特許庁がした審決を取り消す
参照条文	特許法第29条第2項
キーワード	進歩性、周知技術

〔事実関係〕

1. 事案の概要

特許庁がした審決に対して、その審決が取り消された事件である。

2. 発明の内容

※下線部は、今回取り上げる（相違点2）に関連する部分を示す。

（請求項1）

（a）上面と、前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と、前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程、

（b）複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に、それぞれ搭載する工程、

（c）前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第1パッドとを、複数のワイヤで接続する工程、

（d）前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程、

（e）前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し、複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程、を含み、

取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、複数の第2パッドと、複数の配線と、アドレス情報パターンとを有し、

分割された前記マトリクス基板の前記上面は、前記樹脂で覆われており、前記複数の配線は、前記複数の第2パッドのそれぞれと一体に形成され、

前記アドレス情報パターンは、前記複数の第2パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており、

前記アドレス情報パターンは、前記（b）工程に先立ち、形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。

（本願発明の解決課題）

個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分

割後においても容易に識別できるようにし、もって、製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特特定を迅速に行えるようにする解決課題

(本願発明の課題解決手段)

マトリクス基板の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち、マトリクス基板の下面のパッド及び配線を除く領域に、アドレス情報パターンを形成すると構成を採用すること

### 3. 争点

本願発明と引用発明との相違点(相違点2)について、周知例1～3に基づいて引用発明から容易に想到できたものであるか。

(相違点2)

本願発明では、分割された前記マトリクス基板の前記下面に、アドレス情報パターンとを有し、前記アドレス情報パターンは、前記複数の第2パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており、前記アドレス情報パターンは、前記(b)工程に先立ち、形成されているのに対し、引用発明では、このような構成は備えていない点。

### 4. 裁判所の判断

4-1. 裁判所は、一般的な判示事項として下記のとおり述べている。

(a) 当該発明が、発明の進歩性を有しないこと(すなわち、容易に発明をすることができたこと)を立証するに当たっては、公平かつ客観的な立証を担保する観点から、次のような論証が求められる。

(b) すなわち、当該発明と、これに最も近似する公知発明(主引用発明)とを対比した上、当該発明の引用発明との相違点に係る技術的構成を確定させ、次いで、主たる引用発明から出発して、これに他の公知技術(副引用発明)を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に至ることが容易であるとの立証を尽くしたといえるか否かによって、判断をすることが実務上行われている。

(c) この場合に、主引用発明及び副引用発明の技術内容は、引用文献の記載を基礎として、客観的かつ具体的に認定・確定されるべきであって、引用文献に記載された技術内容を抽象化したり、一般化したり、上位概念化したりすることは、恣意的な判断を容れるおそれが生じるため、許されないものといえる。そのような評価は、当該発明の容易想到性の有無を判断する最終過程において、総合的な価値判断をする際に、はじめて許容される余地があるというべきである。

(d) ところで、当業者の技術常識ないし周知技術についても、主張、立証をすること

なく当然の前提とされるものではなく、裁判手続（審査、審判手続も含む。）において、証明されることにより、初めて判断の基礎とされる。

（e）他方、当業者の技術常識ないし周知技術は、必ずしも、常に特定の引用文献に記載されているわけではないため、立証に困難を伴う場合は、少なくない。しかし、当業者の技術常識ないし周知技術の主張、立証に当たっては、そのような困難な実情が存在するからといって、

①当業者の技術常識ないし周知技術の認定、確定に当たって、特定の引用文献の具体的な記載から離れて、抽象化、一般化ないし上位概念化をすることが、当然に許容されるわけではなく、また、

②特定の公知文献に記載されている公知技術について、主張、立証を尽くすことなく、当業者の技術常識ないし周知技術であるかのように扱うことが、当然に許容されるわけではなく、さらに、

③主引用発明に副引用発明を組み合わせることによって、当該発明の相違点に係る技術的構成に到達することが容易であるか否かという上記の判断構造を省略して、容易であるとの結論を導くことが、当然に許容されるわけではないことはいうまでもない。

4-2. 裁判所は、上記判事事項に基づいて、本願発明の相違点2に係る構成の容易想到性の有無について、次のように判断した。

引用発明は、本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題（個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにし、もって、製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行えるようにする）及び解決手段（マトリクス基盤の上面に複数の半導体チップを搭載する工程に先立ち、マトリクス基盤の下面のパッド及び配線を除く領域に、アドレス情報パターンを形成するとの構成を採用する）ことについては、何らの記載も示唆もない。

したがって、被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う」との技術が、周知技術又は当業者の技術常識であるか否かにかかわらず、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であるとはいえない。

のみならず、被告の主張に係る「製造工程において素材あるいは製品を分割して、個々の製品を製造する場合に、分割前の素材に、素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき、製品となった後に、その記号等を利用して分割前の場所に起因する不

良解析を行う」との技術が、周知例1ないし3の具体的な記載内容を超えて、技術内容を抽象化ないし上位概念化することなく、当然に周知技術又は当業者の技術常識であると認定することもできない。

さらに、周知例1ないし3には、本願発明の相違点2に係る構成を採用することによる解決課題及び解決手段に係る事項についての記載も示唆もない。そうである以上、引用発明を起点として、周知技術を適用することによって本願発明に至ることが容易であると解することはできない。

以上